

期刊	编辑观点	高层观点	封面故事	趋势洞察	元件与模组	分销与供应链	制造与工艺	特刊
1月刊 广告预订截止日期: 2025年11月21日 材料提交截止日期: 2025年11月28日	·	·	2026年电子行业趋势	消费电子市场现状	电源芯片/模块	电子/分销行业新年展望	-	-
2月刊 广告预订截止日期: 2025年12月22日 材料提交截止日期: 2025年12月30日	·	·	全球供应链的多元链潮	芯片出海	存储主控	可持续供应链	自动化测试	-
3月刊 广告预订截止日期: 2026年1月20日 材料提交截止日期: 2026年1月28日	·	·	智能制造与数字化供应链	机器视觉	传感器	供应链管理	-	-
4月刊 广告预订截止日期: 2026年2月25日 材料提交截止日期: 2026年2月27日	·	·	AI手机/AI PC应用	VR/AR	电容/电阻/电感	元器件电商	PCB制造	-
5月刊 广告预订截止日期: 2026年3月20日 材料提交截止日期: 2026年3月30日	·	·	新能源与智能驾驶深度融合	AI定义汽车	无线模块	供应链服务	-	-
6月刊 广告预订截止日期: 2026年4月20日 材料提交截止日期: 2026年4月30日	·	·	2025年度全球/中国分销商排名	2025国产存储市场分析	光通信芯片	国产供应链	半导体设备	-
7月刊 广告预订截止日期: 2026年5月20日 材料提交截止日期: 2026年5月29日	·	·	国产SiC急速上车	脑机接口/智慧医疗	GaN器件	智能仓储	-	-
8月刊 广告预订截止日期: 2026年6月19日 材料提交截止日期: 2026年6月30日	·	·	人形机器人量产元年	工业电子市场	微型电机	技术分销	半导体封装	-
9月刊 广告预订截止日期: 2026年7月20日 材料提交截止日期: 2026年7月30日	·	·	智能家居迈向主动智能	智能穿戴	RISC-V	小批量分销	-	-
10月刊 广告预订截止日期: 2026年8月20日 材料提交截止日期: 2026年8月28日	·	·	AI眼镜催生下一个供应链风口	显示趋势	ASIC芯片	分销商并购	新材料应用	-
11月刊 广告预订截止日期: 2026年9月21日 材料提交截止日期: 2026年9月25日	·	·	GPU/AI芯片:万卡智算集群构建	数据中心	图像传感器	AI赋能分销	-	-
12月刊 广告预订截止日期: 2026年10月20日 材料提交截止日期: 2026年10月30日	·	·	封芯跃迁:先进封装重塑半导体疆界	晶圆代工趋势	射频前端	库存管理	晶圆制造	分销与供应链专刊

有关编辑查询和其他相关事项:

请与 Clover Lee (clover.lee@aspencore.com) 联系。

注: 封面故事、元件与模组、分销与供应链所列主题需采访企业; 编辑观点、趋势洞察、制造与工艺所列主题以深度原创为主; 发行人保留对以上文章删除及改动的权利。